

Information

2023年5月9日

日本実装技術新興協会の第220回定例講演会 “次世代半導体開発と実装技術に向けた最新動向”に登壇します

日機装株式会社は、一般社団法人日本実装技術新興協会が主催する「第220回定例講演会」に登壇します。

5月25日（木）に開催される第220回定例講演会のプログラムは「次世代半導体開発と実装技術に向けた最新動向」をテーマとしており、15:40~16:25に行われる講演にて、当社のインダストリアル事業本部 精密機器技術センターの牧野 由が登壇します。当社独自の特殊ゲル状加圧媒体を用いた立体的な3Dプレス方法での均一圧着により、効率的かつ高品質なモジュール製造が可能となる技術や、パワー半導体の接合特性に合ったシンタリング（焼結）装置「3Dシンター」の開発内容についてご紹介します。

皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

講演会名	第220回定例講演会 https://www.j-jisso.org/pdf/220.pdf
開催日時	2023年5月25日（木）13:20 ~ 17:10
開催方式	ハイブリッド方式：川崎市産業振興会館（会員のみ）+WEB会議システム「zoomウェビナー」
プログラム	<p>“次世代半導体開発と実装技術に向けた最新動向”</p> <p>① 「半導体戦略」（13:20~14:20） 東京大学大学院工学系研究科 教授/システムデザイン研究センター センター長 黒田 忠広 氏</p> <p>② 「エレクトロニクスを取り巻く世界の動きと日本の戦略」（14:30~15:30） インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティング ディレクター 南川 明 氏</p> <p>③ 「パワー半導体向け 3D プレス技術とシンタリング（焼結）装置開発」（15:40~16:25） 日機装株式会社 インダストリアル事業本部 精密機器技術センター技術部 開発グループ/主査 牧野 由 氏</p> <p>④ 「ポスト 5G/6G を見据えた先端パッケージ基板のための微細配線形成技術」（16:25~17:10） 奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所 総合技術研究部 次長 北 晃治 氏</p>

参加費	<p>会員：無料</p> <p>非会員：22,000 円/人</p>
申込方法	<p>会員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いいたします。</p> <p>非会員：参加形式は Zoom ウェビナーのみになります。ホームページのお問い合わせフォーム（https://www.j-jisso.org/p/contact.html）より「お問い合わせ内容」の項目に第 220 回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。</p>
申込締切日	<p>会員：5月17日（水）</p> <p>非会員：5月10日（水）</p>
HP	https://www.j-jisso.org/

本件に関するお問い合わせ先

日機装株式会社 インダストリアル事業本部 精密機器事業
 精密機器東日本営業一部 国内営業グループ <kouatsu-tokyo@nikkiso.co.jp>
[TEL:03-3443-3753](tel:03-3443-3753)